

# Explore the future

株式会社堀場製作所  
2005年3月期決算説明会  
代表取締役社長 堀場 厚

2005年5月13日

**HORIBA**

(C) HORIBA, Ltd.

## 免責事項

本プレゼンテーション資料には、株式会社堀場製作所の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競争状況、為替レートなどの潜在的风险や不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

Explore the future

**HORIBA**

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 説明内容

- 決算サマリー
- 業績予想
- セグメント別詳細説明
- 経営上の取組事項

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 2005年3月期 連結決算概要

売上高、営業・経常・当期利益過去最高額を計上

営業利益率10%達成(8.1% 10.1%)

将来の損失リスク積極処理(特別損失28億円計上)

税負担率改善(53.8% 37.5%) 当期利益1.7倍

P/L

エンジン計測システム、半導体システム好調

有利子負債削減(214億円 160億円)

リスク資産積極償却(減損資産の売却・会計処理実施)

ROE上昇 5.0% 7.4%

B/S

効率経営・バランスシート健全化推進

C/F

利益拡大により営業キャッシュフロー72億円計上

キャッシュフロー重視経営の継続

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 2005年3月期連結業績

(金額:億円)

	2004年3月期	2005年3月期	
	実績	実績	増減
売上高	850	924	+74 (+8.7%)
営業利益	68	93	+25 (+36.8%)
営業利益率	8.1%	10.1%	+2.0P
経常利益	55	88	+33 (+58.7%)
当期利益	20	35	+15 (+69.9%)
ROE	5.0%	7.4%	+2.4P

Explore the future

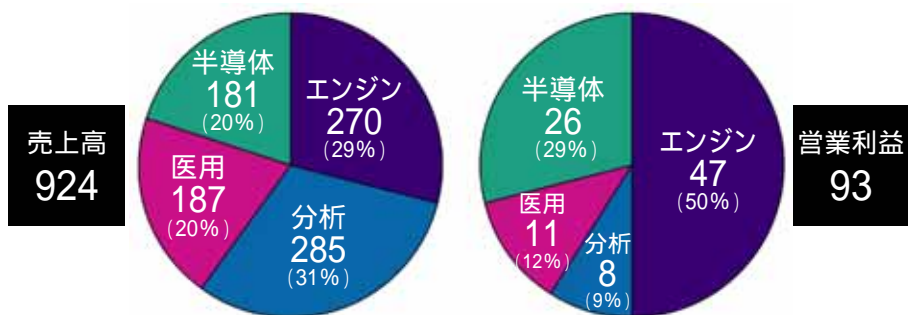
**HORIBA**

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## セグメント別業績概要

(金額:億円)

### セグメント別 金額・構成比



対前年比	エンジン	売上高 14.6%増	営業利益 35.0%増
	分析	売上高 3.1%減	営業利益 15.6%減
	医用	売上高 8.5%増	営業利益 24.0%減
	半導体	売上高 23.2%増	営業利益 218.5%増

Explore the future

**HORIBA**

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 説明内容

- 決算サマリー
- 業績予想
- セグメント別詳細説明
- 経営上の取組事項

Explore the future

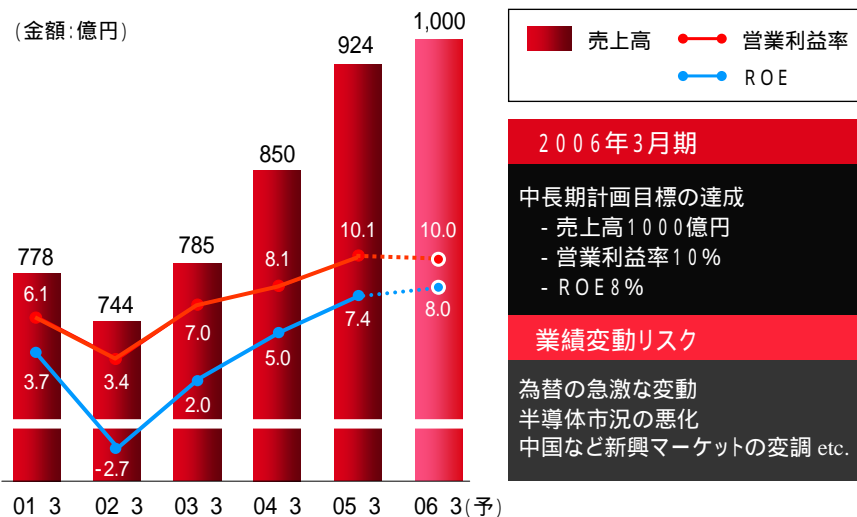
HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

全社

## 連結売上高・営業利益率・ROE推移

(金額:億円)



Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 2006年3月期 連結業績予想

(金額:億円)

	2005年3月期	2006年3月期	
	実績	予想	増減
売上高	924	1,000	+76 (+8.1%)
営業利益	93	100	+7 (+6.7%)
営業利益率	10.1%	10.0%	0.1P
経常利益	88	90	+2 (+1.3%)
当期利益	35	46	+11 (+30.5%)
ROE	7.4%	8.0%	+0.6P
為替レート	2005年度予想 US\$ = 103円 EUR = 135円 2004年度実績 US\$ = 108円 EUR = 134円 円高の影響 1円につきドル 5,100万円、ユーロ 2,200万円営業減益		

Explore the future

**HORIBA**

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 2006年3月期セグメント別業績予想

(金額:億円)

	売上高	前期比	営業利益	前期比
エンジン	272	+0.7%	48	+2.0%
分析	318	+11.5%	10	+16.0%
医用	220	+17.2%	20	+74.6%
半導体	190	+4.5%	22	17.3%
合計	1,000	+8.1%	100	+6.7%

Explore the future

**HORIBA**

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 説明内容

- 決算サマリー
- 業績予想
- セグメント別詳細説明
- 経営上の取組事項

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 全社事業戦略

4つのセグメントをバランスよく成長させる

→ 全社ベースの業績振れ幅を抑え、経営を安定化

↓  
セグメント間のスムーズなリソース移動が可能

↓  
効率経営を推進

トータルソリューション提供により収益性を高める

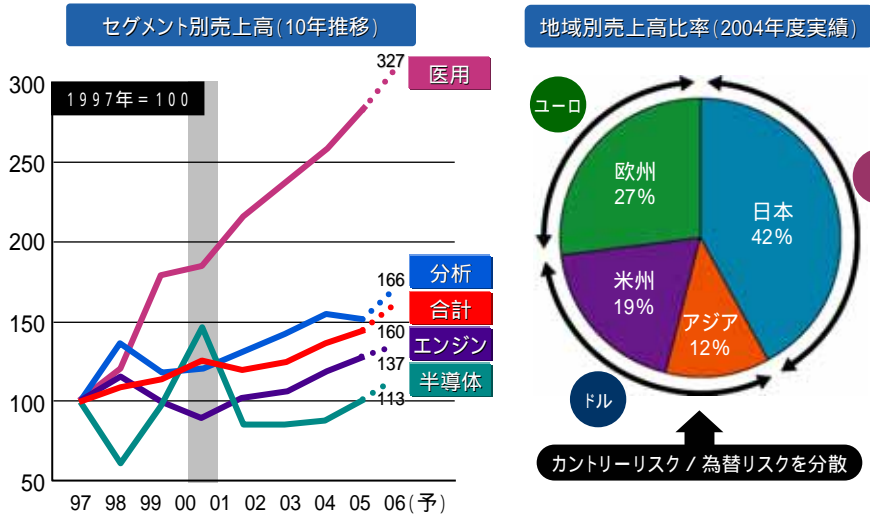
単なる分析・計測にとどまらず、システム全体の  
制御を含む、より付加価値の高いサービスを提供

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## バランス経営 ~ 事業・エリア分散によるリスク回避 ~

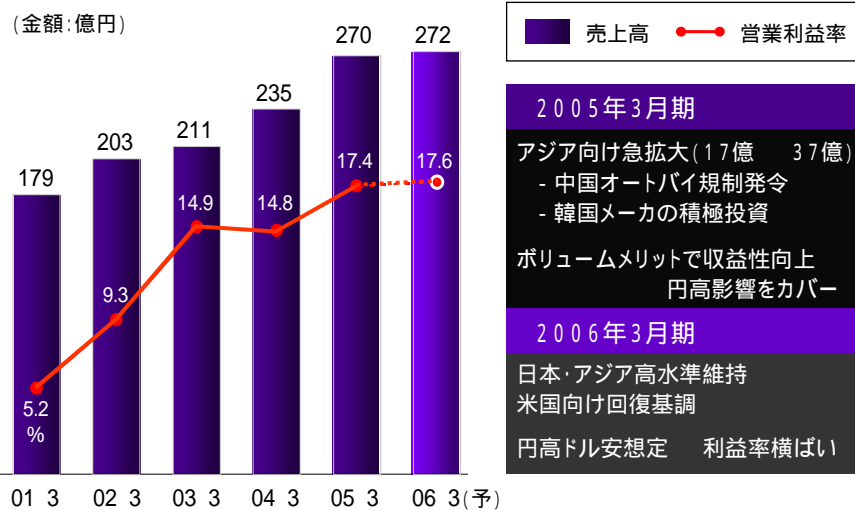


Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## エンジン 連結セグメント別売上高・営業利益率推移



Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

# エンジン

主力製品



エンジン排ガス測定装置

排ガス計測ビジネスの変化に応じた事業対象領域拡大

## エリア別市場動向

日本 (112)	+	新規投資継続(開発期間短縮・Diesel/Hybrid開発)
	-	景気・為替の自動車産業への影響
米国 (41)	+	2007年規制対応急務
	-	ビッグ3の業績低迷
欧州 (79)	+	フランス継続拡大、東欧・ロシア急成長
	-	ドイツ下落傾向
中国 (17)	+	自動車産業発展とリンクした設備投資継続
	-	オートバイ規制需要減少、カントリーリスク
韓国 (10)	+	自動車産業輸出好調で設備投資活発化
	-	顧客が限定的

( )内  
前売上高(億円)

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

# エンジン

主力製品



エンジン排ガス測定装置

排ガス計測ビジネスの変化に応じた事業対象領域拡大

## 排ガス規制動向

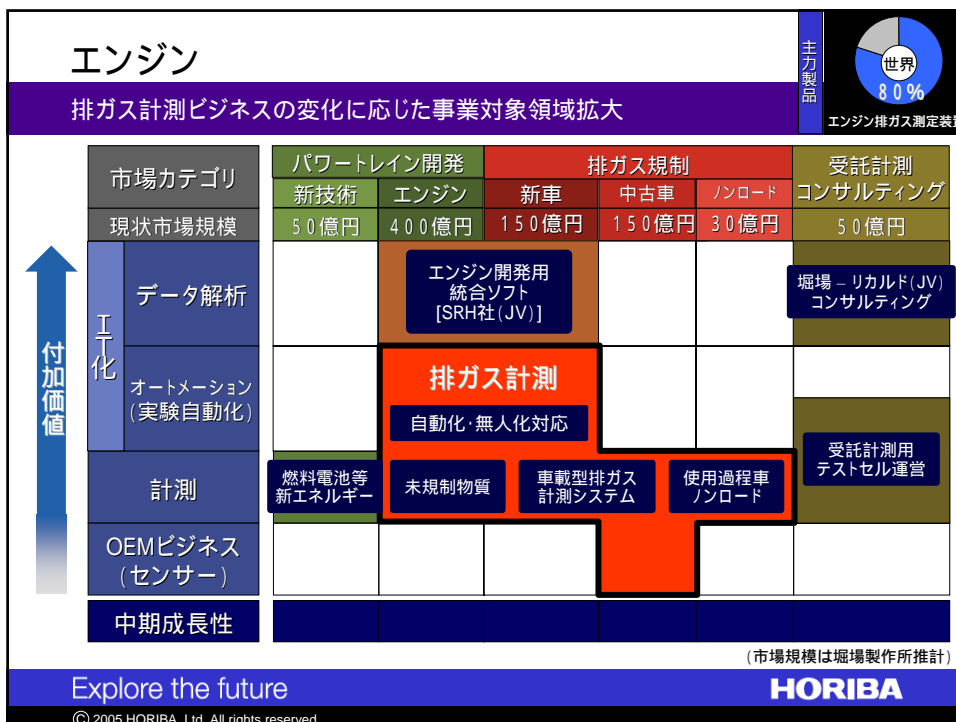
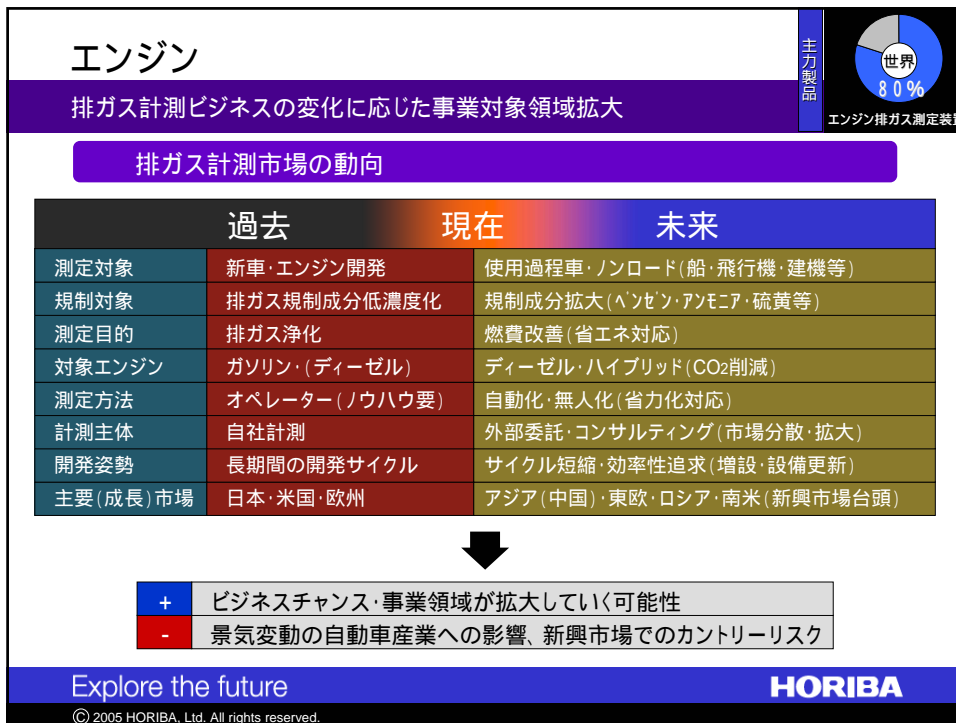
日本	2005年 新長期規制	2009年 ポスト新長期 (世界最高水準のNOx/PM規制)
米国	2004~2007年 Tier 2 段階的導入	
欧州	2005年 EURO 4	2008~2010年 EURO 5
新興国 (中国・アジア諸国)	EURO規制に追従、使用過程車向け規制強化	
グローバル	京都議定書 CO2削減に向けた燃費改善	

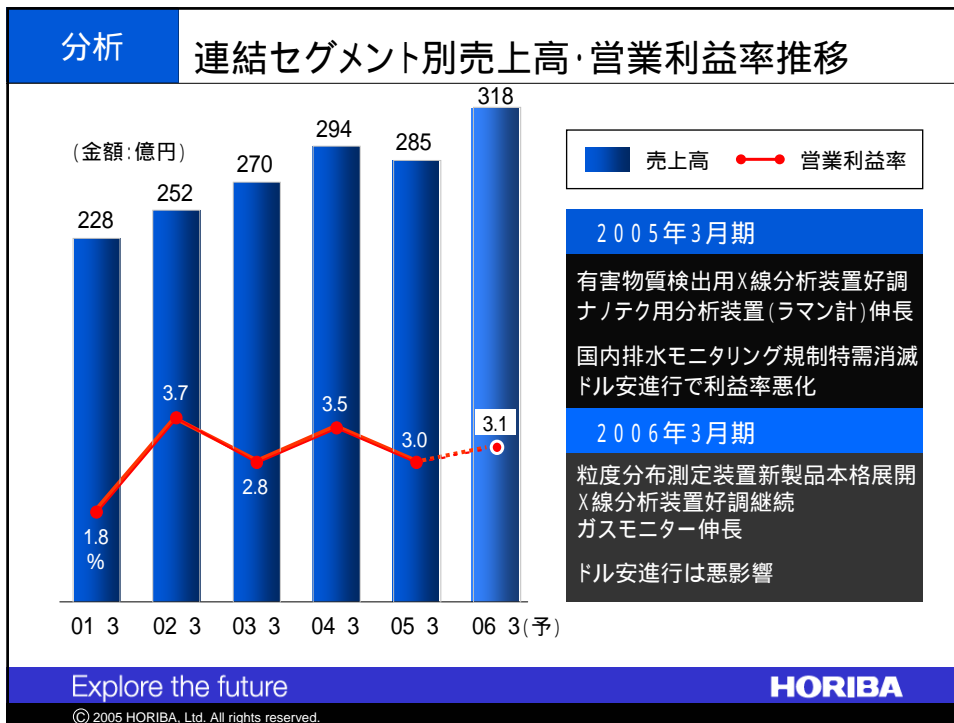
Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.







## 分析

事業ごとに最適化された戦略でグローバル・ニッチマーケットを攻略

**理科学** 売上 前期195億円 今期220億円

WEEE-ROHS指令関連、X線分析装置需要継続拡大

**市場がシフト** セットメーカー 部品・素材メーカー  
日本 中国・韓国・台湾

粒度分布測定装置新製品投入

**全世界同時に拡販** 超ワイドレンジ(10ナノm~3ミリm)  
高精度・高速測定

ナノテク分析市場拡大継続(ラマン分光計等)

**測定対象微細化** カーボン・ナノチューブ、有機EL、製薬、化合物半導体 etc.

**環境** 売上 前期90億円 今期98億円

事業領域拡大とコストダウンによる収益向上

リプレイス需要増加の環境規制市場にコストダウン新製品投入 **シェアUP / 利益確保**  
非規制分野のガス・水質モニタリング市場を積極開拓 **事業領域拡大 / 売上増**  
中国潜在マーケットへの取組(技術交流、サービス強化等) **エリア拡大 / 売上増**

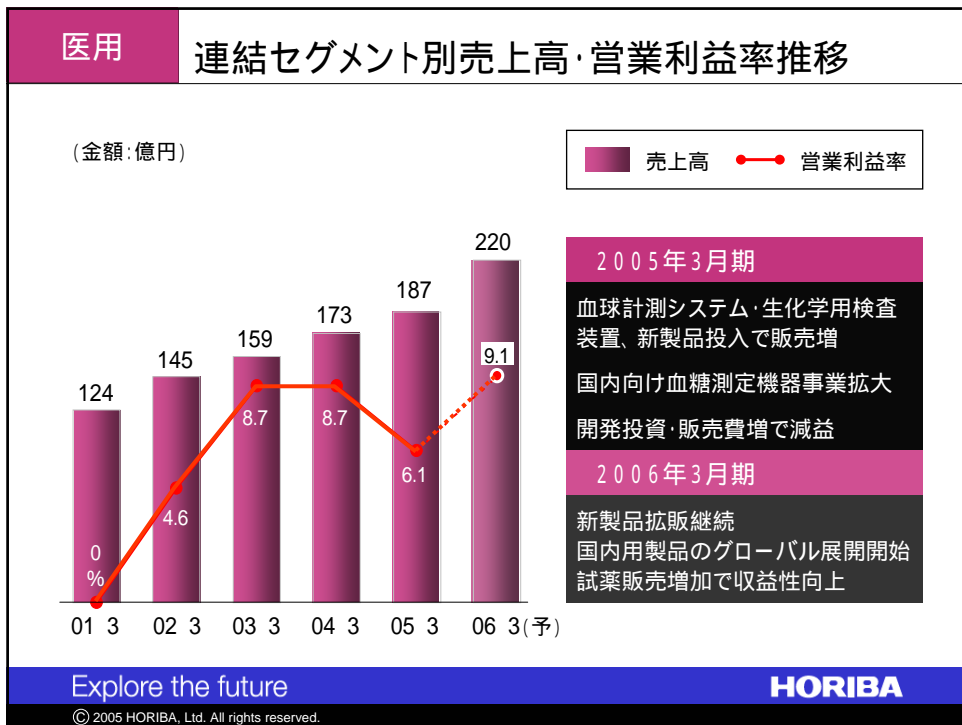
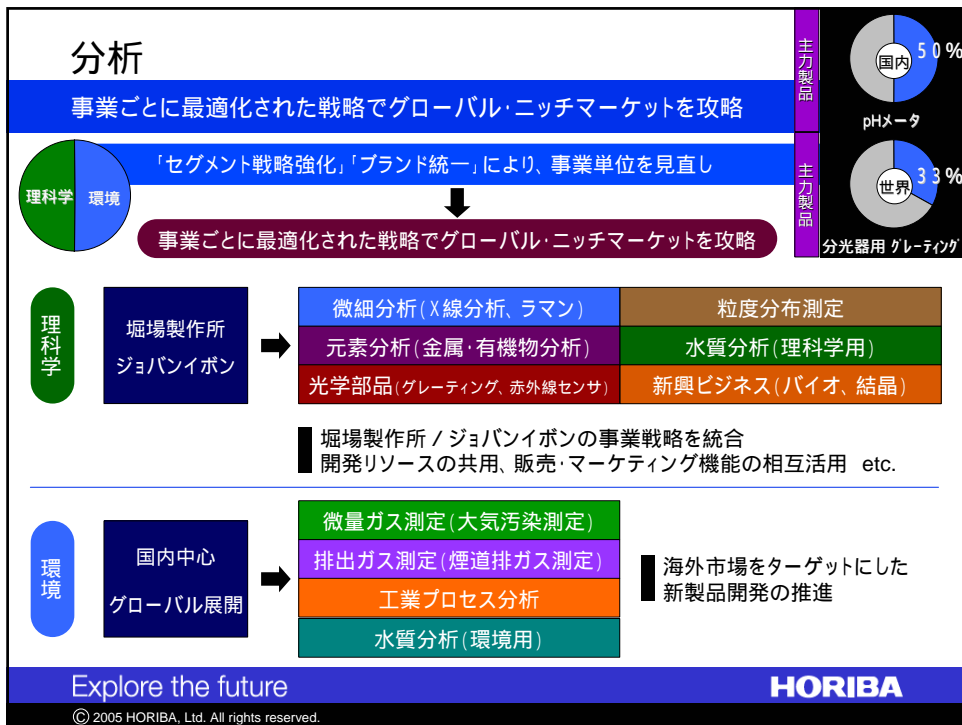
主力製品

40% 国内

粒度分布測定装置

Explore the future **HORIBA**

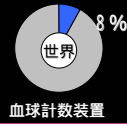
© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.



# 医用

小型血球計測装置から中・大型、生化学への展開 ~ 第2の成長へ

主力製品

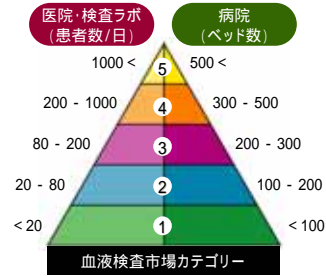


## 製品ラインナップ拡充 ~ 血球計測小型機の成功をベースに展開

2004年度 血球計測大型機、生化学中型機投入  
欧州市場中心に好調 (前期売上9億円計上)

今後の製品展開

- 日本市場向け小型機グローバル展開 2005 ~  
(血球・CRP複合機、血糖測定機)
- 中型機 (血球・生化学) 2006 ~ 2007
- 大型機 (血球) 2007 ~ 2008
- 超大型機 (血球) 2009 ~



## 中期ターゲット(2009年3月期)

検体検査市場世界シェア2.2%、血球計測市場世界シェア13%  
収益性の高い検査試薬の売上比率45% 55~60%にアップ  
市場規模の大きい生化学分野の売上比率15% 25%にアップ

売上高 300 ~ 350億円 営業利益率 15%以上

Explore the future

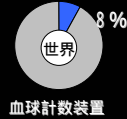
HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

# 医用

小型血球計測装置から中・大型、生化学への展開 ~ 第2の成長へ

主力製品



検査カテゴリ	生化学	血液		免疫
		血球計測	凝固	
市場規模	1兆円	2千億円	1千億円	1兆円
病院 検査センター		血球検査システム (自社開発)		
	中小病院	生化学分析装置 (ロシュ社:MIIRA 自社開発製品)	凝固試薬 (BIO PEP社)	
開業医	血糖値測定 (三共より買収)	中・小型 血球計数装置		ぜん息薬測定 CRP計測 (炎症検査)
病棟・手術場 (POCT)	小型生化学			

Explore the future

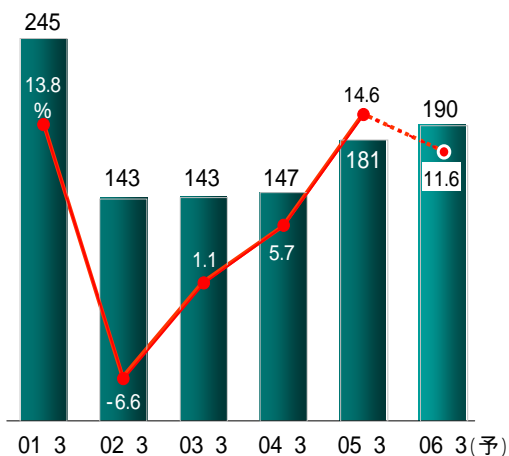
HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 半導体

### 連結セグメント別売上高・営業利益率推移

(金額:億円)



■ 売上高 ● 営業利益率

#### 2005年3月期

半導体製造装置向け  
マスフローコントローラ販売増加  
(上半期大幅増 下半期減速)  
洗浄装置用薬液モニター好調

#### 2006年3月期

半導体市場減速想定  
マスフローコントローラ  
米国市場向け悪化懸念  
新製品投入で年度後半回復見込む

Explore the future

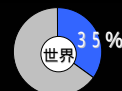
HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 半導体

### 半導体市場300mm化への対応

主力製品



マスフローコントローラ

#### 300mm市場へのシフト対応

半導体  
マーケット

前下半期から下落基調、先行き不透明  
(今期、半導体マーケット10%減を想定)  
半導体製造装置市場が200mm → 300mmへ急速にシフト  
(直近70~80%程度が300mm装置)

今期の取組み

新製品投入・営業努力による300mmマーケットでの  
マスフローコントローラシェア回復  
半導体歩留率向上に寄与する残留ガス分析計、真空計の販売拡大

#### 半導体サイクルの影響を軽減するビジネスの拡大

##### マスフローコントローラ以外の製品群充実

液晶・半導体向け薄膜検査装置販売拡大  
クリーンルーム内ガスモニター本格投入  
化合物半導体製造装置メーカー(株)アセックを100%子会社化

約20億円の  
増収効果

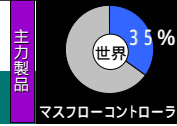
Explore the future

HORIBA

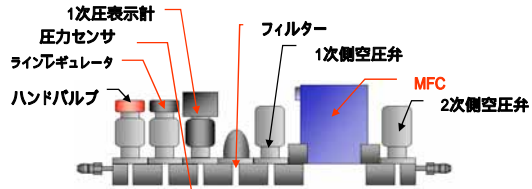
© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

# 半導体

差圧方式マスフローコントローラ ~ 戦略新製品の市場投入



## 従来のガスパネルデザイン



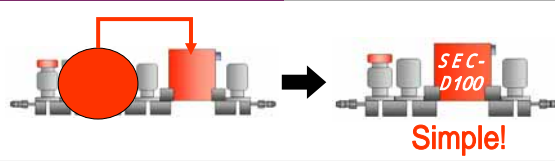
## 次世代-差圧式マスフローコントローラ

圧力変動に影響を受けない  
歩留り率向上に貢献

圧力センサ、レギュレータ不要

↓  
半導体製造装置ガスパネル  
コストダウン・コンパクト化を実現

## 新型のガスパネルデザイン



量産化対応中(夏以降市場本格投入予定)

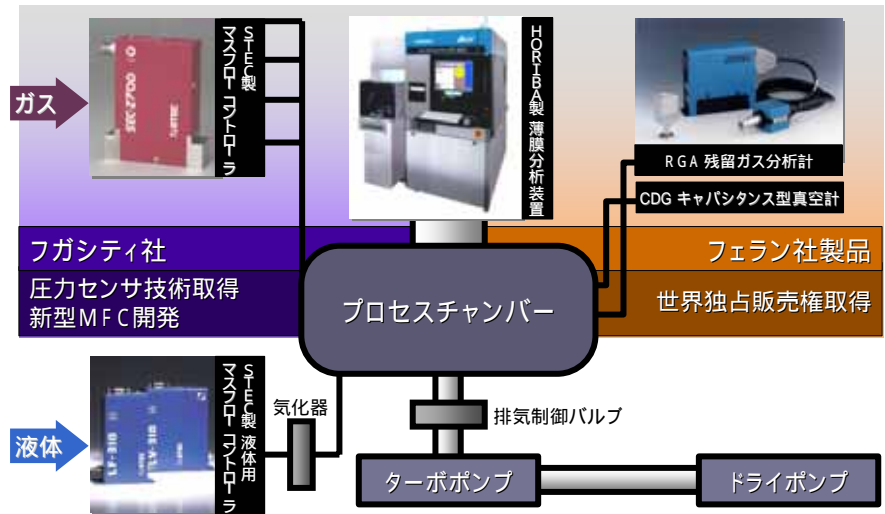
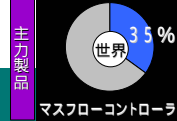
Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

# 半導体

半導体プロセスチャンバ周辺のトータルソリューション提供



Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## トピックス：中国における事業活動状況

### 基本政策

巨大な潜在市場として中長期的な観点で拠点整備、人材育成を実施  
 カントリーリスク回避のため、当面コア技術の移転 / 生産の集約化は行わない



#### 現地拠点

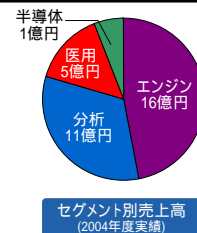
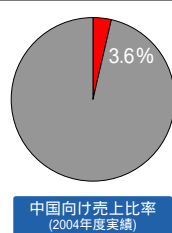
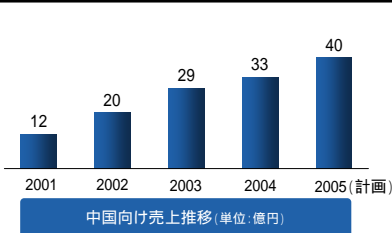
上海 生産会社(現地法人)、貿易会社(現地法人)  
 駐在員事務所(現地営業事務所)  
 北京 駐在員事務所(現地営業事務所)

#### 現地従業員数

約70名(うち日本人出向者5名)

中国向け売上高 33億円(2004年度実績)

中国現地生産高 2億円(2004年度実績)



Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 説明内容

- 決算サマリー
- 業績予想
- セグメント別詳細説明
- 経営上の取組事項

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 経営上の重点取組事項

基本方針: 継続的な企業価値(株主価値)向上をめざす

企業責任、社会貢献、コンプライアンス重視

**「HORIBAだからできること」を地道に実践**

ビジネスを通じて「環境」「健康」「安全」に貢献  
オープン＆フェアの精神で企業を運営

投資効率、財務体質の改善

B/S、C/F重視の経営推進(有利子負債削減)  
将来リスクの前倒し処理(役員退職慰労引当金一括処理)

経営システムの変革

「One Company経営」の推進

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 経営システムの変革

「One Company経営」の推進

**HORIBA GROUP is One Company**

HORIBAグループは、統一されたブランドの下、  
ビジョン・戦略を共有し、One Companyとして、  
グループの企業価値・利益最大化を追求する

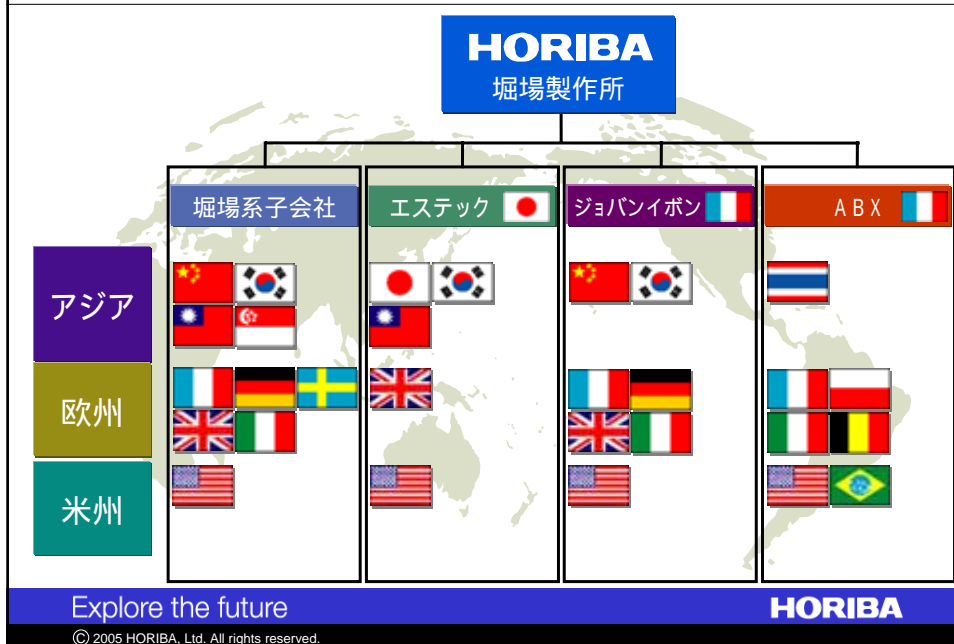
Explore the future

HORIBA

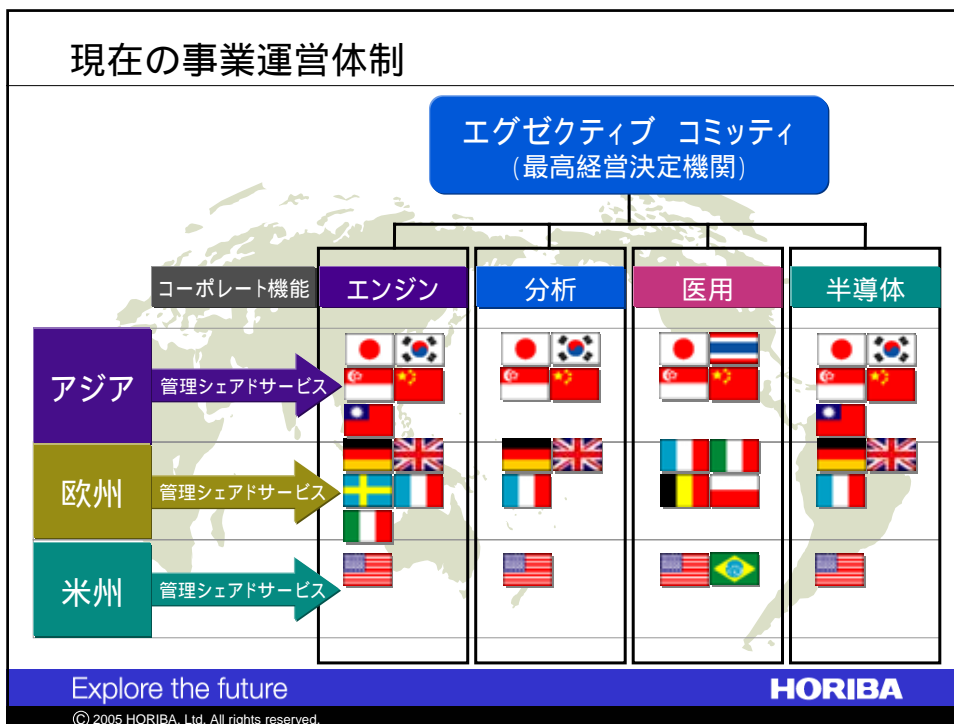
© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.



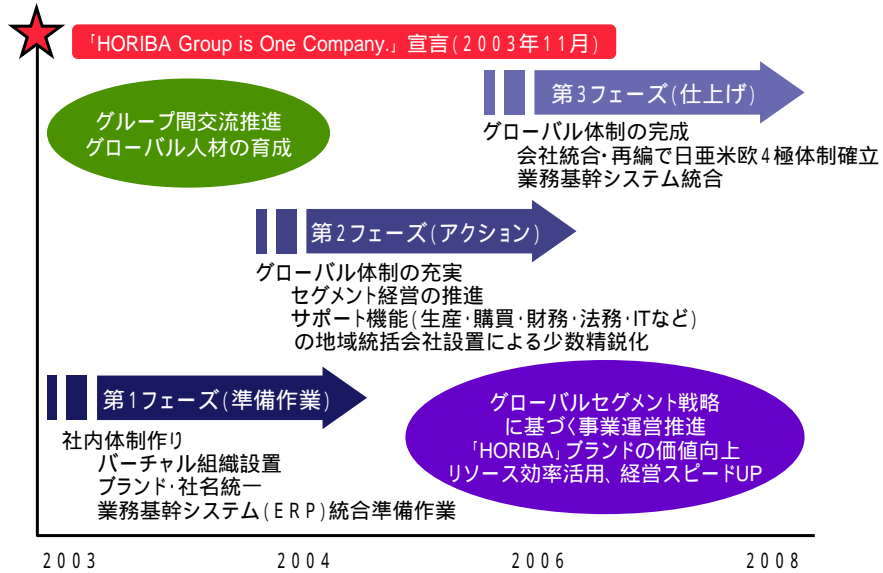
## 従来の事業運営体制



## 現在の事業運営体制



## 「One Company」進捗状況と今後の取り組み



Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 「One Company」における資本政策

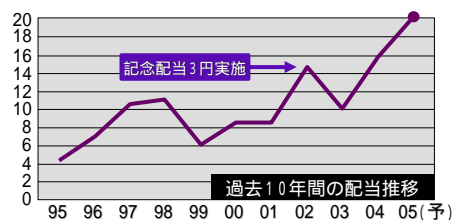
配当政策 ~ 基準配当性向制度採用 (堀場製作所単体純利益 × 30%)

企業の成長にリンクした配当を実施  
成長を持続するための投資資金として70%分を内部留保として確保  
中期的には自己資本と投資のバランスを考慮し、最適な配当政策を選択

今期増額見込(過去最高額)

前期実績 16円 (うち中間3円)

今期予想 20円 (うち中間6円)



企業価値外部流出防止のためグループ会社の100%子会社化推進

株式交換による堀場エステック100%子会社化実施 (従来持株比率78.5%)

株式交換日: 2005年3月21日 | 連結純資産 24億円増加  
発行新株式数: 1,614,750株 | 少数株主持分利益約2億円の取り込み

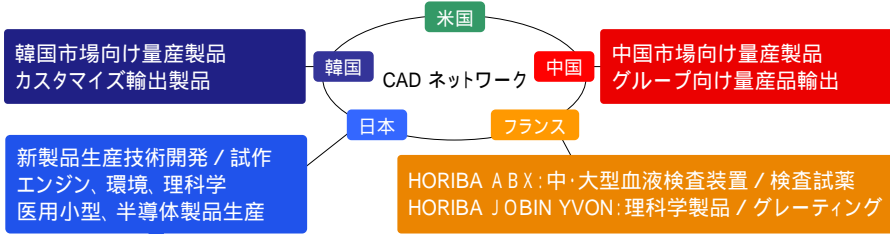
Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 「One Company」におけるグローバル生産戦略

グローバル生産戦略 ~ 生産拠点の役割を明確にし、最適地生産を行う



堀場エステック阿蘇工場増設 ~ One Company モデル工場としてグループ製品を量産

生産品目:  
マスフローコントローラ、真空計  
理科学小型製品、半導体検査装置  
医用検査試薬 etc.

現工場 2,470 m<sup>2</sup> 増設後 7,340 m<sup>2</sup>  
(床面積3倍)  
総投資額 1.5 億円



完成予想図 2005年10月竣工(予定)

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

## 次期中長期計画について

今期  
最優先事項

売上高1,000億円、営業利益率10%、ROE8%の現中長期計画達成



現中長期計画をステップに、次期中長期計画で  
真のエクセレントカンパニーをめざす

次期中長期計画

コンセプト

長期ビジョン(めざす姿)を明確に定義し、ステークホルダーと共有する  
経営指標(KPI)とその目標数値を公表し、評価の客観性を確保する  
「HORIBA」ブランドを核に企業規模の拡大をめざすと同時に、  
収益性を追求し、株主価値向上を図る

ポイント

グローバルな事業展開

HORIBAブランド強化

M&Aの積極活用

事業拡大にともなう効率化

世界で通用する人材の継続的育成

今秋創業60周年時に策定

2006年発表予定

Explore the future

HORIBA

© 2005 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

